

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-077117

(43)Date of publication of application : 23.03.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/3205  
H01L 21/304  
H01L 21/3063  
H01L 21/768  
H01L 29/78  
H01L 29/786

(21)Application number : 11-253605

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 07.09.1999

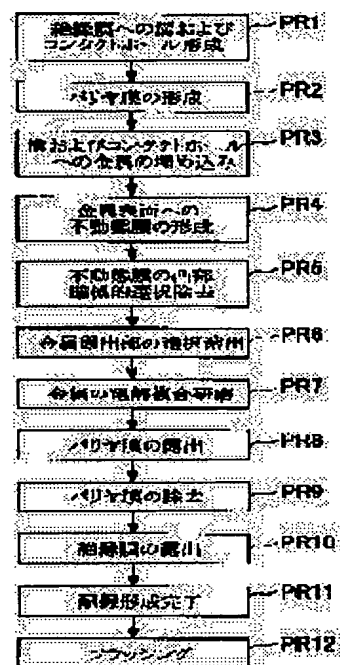
(72)Inventor : NOGAMI TAKESHI  
YUBI HIROSHI  
SATO SHUZO

## (54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE, AND METHOD AND DEVICE FOR POLISHING

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a polishing method, a polishing device, and a manufacturing method for a semiconductor device, where occurrence of dishing or erosion is suppressed in a planarizing process for polishing a metal film to constitute wiring of a semiconductor device having a multilayer interconnection structure.

**SOLUTION:** A process (PR4) for forming a passive state film on the surface of a metal film which prevents electrolytic reaction of the metal, process (PR5) where a protruding passive state film present on the surface of metal film which is generated by filling a wiring channel is selectively removed by mechanical polishing so that the protruding metal film is exposed on the surface, a process (PR6) where the exposed protruding part of the metal film is removed by electrolytic polishing, so that the rough surface of the metal film generated by filling of the wiring channel is planarized, and a process (PR7) where a metal film present on the insulating film of the metal film whose surface is planarized is removed by electrolytic composite polishing, where electrolytic polishing and mechanical polishing are composed to form wiring are provided.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-77117

(P2001-77117A)

(43) 公開日 平成13年3月23日 (2001.3.23)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 1 L 21/3205		H 0 1 L 21/88	K 5 F 0 3 3
21/304	6 2 2	21/304	6 2 2 X 5 F 0 4 0
21/3063		21/306	L 5 F 0 4 3
21/768		21/90	C 5 F 1 1 0
29/78		29/78	3 0 1 N

審査請求 未請求 請求項の数48 ○L (全 22 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平11-253605

(22) 出願日 平成11年9月7日 (1999.9.7)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 野上 毅

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 由尾 啓

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(74) 代理人 100094053

弁理士 佐藤 隆久

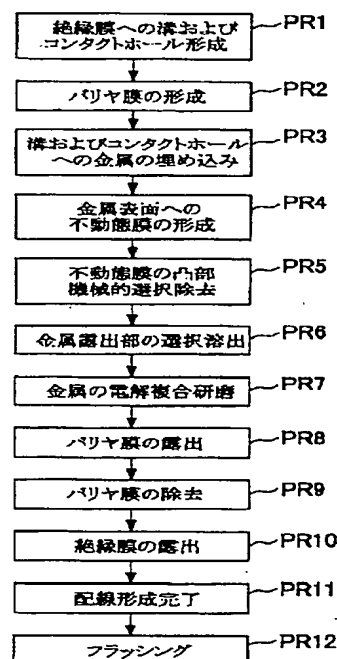
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法、研磨装置および研磨方法

## (57) 【要約】

【課題】多層配線構造を有する半導体装置の配線を構成するための金属膜の研磨による平坦化工程において、ディッシング、エロージョンの発生を抑制可能な、研磨方法、研磨装置および半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】金属膜の表面に当該金属の電解反応を妨げる作用を発揮する不動態膜を形成する工程 (PR4) と、配線用溝の埋め込みによって生じた金属膜の表面に存在する凸部上の不動態膜を機械研磨によって選択的に除去し、金属膜の凸部を表面に露出させる工程 (PR5) と、露出した金属膜の凸部を電解研磨によって除去し、配線用溝の埋め込みによって生じた金属膜の表面の凹凸を平坦化する工程 (PR6) と、表面が平坦化された金属膜の絶縁膜上に存在する金属膜を電解研磨と機械研磨とを複合させた電解複合研磨によって除去し、前記配線を形成する工程 (PR7) を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】基板上に形成された絶縁膜に配線を形成するための配線用溝を形成する工程と、  
前記配線用溝を埋め込むように、前記絶縁膜上に金属膜を堆積させる工程と、  
前記絶縁膜上に堆積した金属膜の表面に当該金属膜の電解反応を妨げる作用を発揮する不動態膜を形成する工程と、  
前記金属膜に形成された不動態膜のうち、前記配線用溝の埋め込みによって生じた前記金属膜の表面に存在する凸部上の不動膜を機械研磨によって選択的に除去し、当該金属の凸部を表面に露出させる工程と、  
前記露出した金属膜の凸部を電解研磨によって除去し、前記配線用溝の埋め込みによって生じた前記金属膜の表面の凹凸を平坦化する工程とを有する半導体装置の製造方法。

【請求項 2】前記表面が平坦化された金属膜の前記絶縁膜上に存在する余分な金属膜を電解研磨と機械研磨とを複合させた電解複合研磨によって除去し、前記配線を形成する工程をさらに有する請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 3】前記電解複合研磨は、電解研磨と化学機械研磨とを複合させる請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】前記配線用溝を形成した後に、前記絶縁膜上および前記溝内を覆うように前記金属膜の前記絶縁膜への拡散を防ぐための導電性材料からなるバリア膜を形成し、前記露出した金属膜の凸部を平坦化した後に、前記絶縁膜上に存在する余分な金属膜を前記電解複合研磨によって前記バリア膜が表面に露出するまで除去する工程と、  
前記絶縁膜上に存在する余分なバリア膜を前記絶縁膜が表面に露出するまで前記電解複合研磨によって除去する工程とを有する請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 5】導電性を有する研磨工具の研磨面と前記不動態膜との間に電解液を介在させ、前記金属膜およびバリア膜を陽極とし前記研磨工具を陰極として、前記金属膜およびバリア膜と前記研磨工具との間に電圧を印加し、  
前記研磨工具を前記不動態膜の表面に相対的に移動させて、前記金属膜の凸部に形成された不動態膜を選択的に除去し、  
前記選択的に除去された不動態膜から露出した前記金属膜の凸部を前記電解液の電解作用によって溶出させる請求項 4 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 6】前記研磨工具との間で電圧が印加された電極部材を前記金属膜およびバリア膜に接触または接近させて前記金属膜および前記バリア膜に通電し、  
前記電極部材から前記前記金属膜および前記バリア膜を

經由して前記研磨工具に流れる電流をモニタリングし、当該電流値の大きさに基づいて前記金属膜およびバリア膜の研磨の進行を管理する請求項 5 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 7】前記研磨工具との間で電圧が印加された電極部材を前記金属膜およびバリア膜に接触または接近させて前記金属膜および前記バリア膜に通電し、  
前記電極部材と前記研磨工具との間に発生する電気抵抗の大きさをモニタリングし、当該電気抵抗値に基づいて前記金属膜およびバリア膜の研磨の進行を管理する請求項 5 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 8】前記研磨工具の研磨面と前記不動態膜との間に研磨砥粒を含む化学研磨剤を介在させて前記不動態膜を選択的に除去する請求項 5 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 9】前記金属膜と前記バリア膜とを構成する各材料に対してそれぞれ研磨レートの高い異なる化学研磨剤を用いて前記余分な金属膜とバリア膜とをそれぞれ除去する請求項 5 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 10】前記余分なバリア膜を除去する工程では、前記バリア膜と前記研磨工具との間に印加する電圧を、前記余分な金属膜を除去する工程での前記金属膜と前記研磨工具との間に印加する電圧よりも低くする請求項 5 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 11】前記配線用溝を形成する工程は、前記配線用溝の形成とともに、前記絶縁膜の下層に形成された不純物拡散層または配線と当該絶縁膜上に形成される配線とを接続するためのコンタクトホールを形成する工程を有し、

前記配線用溝に金属を埋め込む工程は、前記配線用溝とともに前記コンタクトホールに金属を埋め込む請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 12】前記配線の形成材料には、銅を使用し、前記配線用溝およびコンタクトホールには電気メッキ法を用いて銅を埋め込む請求項 11 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 13】前記バリア膜の形成材料には、Ta、Ti、Ta<sub>2</sub>N および TiN のいずれかを用いる請求項 4 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 14】前記不動態膜は、前記金属膜の表面を酸化させた酸化膜からなる請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 15】前記金属膜の表面に酸化剤を供給して前記酸化膜を形成する請求項 14 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 16】前記不動態膜は、前記金属膜を構成する金属の電解反応を妨げる作用を発揮する材料からなる膜を前記金属膜の表面上に形成する請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 17】前記不動態膜は、前記金属膜の表面に、

は、水膜、油膜、酸化防止膜、界面活性剤からなる膜、キレート剤からなる膜、および、シランカップリング剤からなる膜のいずれかを形成する請求項 16 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 18】前記不動態膜は、前記金属膜よりも、電気的抵抗が高く、かつ、機械的強度が低い請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 19】研磨面を有し、導電性を有する研磨工具と、

前記研磨工具を所定の回転軸を中心に回転させ、かつ、保持する研磨工具回転保持手段と、

被研磨対象物を保持し所定の回転軸を中心に回転させる回転保持手段と、

前記研磨工具を前記被研磨対象物に対向する方向の目標位置に移動位置決めする移動位置決め手段と、

前記被研磨対象物の被研磨面と前記研磨工具の研磨面とを所定の平面に沿って相対移動させる相対移動手段と、

前記被研磨対象物の被研磨面上に電解液を供給する電解液供給手段と、

前記被研磨対象物の被研磨面を陽極とし前記研磨工具を陰極として、前記被研磨面から前記電解液を通じて前記研磨工具に流れる電解電流を供給する電解電流供給手段とを有する研磨装置。

【請求項 20】前記被研磨対象物の被研磨面に研磨砥粒を含む化学研磨剤を供給する研磨剤供給手段をさらに有する請求項 19 に記載の研磨装置。

【請求項 21】前記電解電流供給手段は、前記被研磨対象物の被研磨面に接触可能または接近可能に配置され、前記被研磨対象物の被研磨面を陽極として当該被研磨面に通電する通電手段と、

前記通電手段と前記研磨工具との間に所定電位を印加する直流電源とを備える請求項 1 に記載の研磨装置。

【請求項 22】前記直流電源は、所定周期のパルス状の電圧を出力する請求項 21 に記載の研磨装置。

【請求項 23】前記研磨工具は、ホイール状の導電性部材からなり、当該部材の環状の一端面が研磨面を構成しており、

前記通電手段は、前記研磨工具の内側に当該研磨工具と離隔して設けられ、前記回転保持手段によって保持され、前記研磨工具とともに回転する導電性の電極板を備える請求項 21 に記載の研磨装置。

【請求項 24】前記電極板は、前記被研磨対象物の被研磨面に対向する側に当該被研磨面をスクラブする面を有するスクラブ部材を備える請求項 23 に記載の研磨装置。

【請求項 25】前記スクラブ部材は、前記電解液および研磨砥粒を含む化学研磨剤を吸収し、かつ通過させることができる材料から形成されており、前記電極板側から供給される電解液および／または化学研磨剤を被研磨対象物の被研磨面に供給する請求項 24 に記載の研磨装

置。

【請求項 26】前記研磨工具は、前記回転保持手段に連結された導電性部材によって保持されており、前記回転する導電性部材に接触する通電ブラシを通じて通電される請求項 21 に記載の研磨装置。

【請求項 27】前記電極部材は、前記被研磨対象物の被研磨面に形成された被電解金属に対して貴なる金属からなる請求項 23 に記載の研磨装置。

【請求項 28】前記被研磨対象物の被研磨面から前記研磨工具に流れる電解電流の値を検出する電流検出手段をさらに備える請求項 19 に記載の研磨装置。

【請求項 29】前記被研磨対象物の被研磨面を経由した前記電極部材と前記研磨工具との間の電気抵抗を検出する抵抗値検出手段を備える請求項 23 に記載の研磨装置。

【請求項 30】前記電流検出手段の検出信号に基づいて、前記電解電流の値が一定となるように前記研磨工具と前記被研磨対象物との対向方向の位置を制御する制御手段をさらに有する請求項 29 に記載の研磨装置。

【請求項 31】被研磨対象物の被研磨面の全面に回転しながら接触する研磨面を有する研磨工具を備え、前記被研磨対象物を前記研磨面に回転させながら接触させて平坦化研磨する研磨装置であって、

前記研磨面上に電解液を供給する電解液供給手段を有し、

前記研磨面に前記被研磨対象物の被研磨面に通電可能な陽極電極および陰極電極を備え、前記電解液による電解研磨と前記研磨面による機械研磨とを複合した電解複合研磨によって前記被研磨対象物の被研磨面を平坦化研磨する研磨装置。

【請求項 32】前記研磨面に研磨砥粒を含む化学研磨剤を供給する研磨剤供給手段をさらに有し、

前記電解液による電解研磨と前記研磨面および前記研磨剤による化学機械研磨とを複合した電解複合研磨によって前記被研磨対象物の被研磨面を平坦化研磨する請求項 31 に記載の研磨装置。

【請求項 33】導電性の研磨工具の研磨面と金属膜が少なくとも表面または内層に形成された被研磨対象物の表面とを電解液を介在させて押し付け、

前記研磨工具を陰極とし前記被研磨対象物の表面を陽極として、前記被研磨対象物の表面から前記研磨工具に前記電解液を通じて流れる電解電流を供給し、

前記研磨工具と前記被研磨対象物とを共に回転させながら所定の平面に沿って相対移動させ、

前記電解液による電解研磨および前記研磨面による機械研磨を複合した電解複合研磨によって前記被研磨対象物に形成された金属膜を平坦化する研磨方法。

【請求項 34】前記研磨面と前記被研磨対象物の表面との間に前記電解液とともに研磨砥粒を含む化学研磨剤を介在させ、前記電解液による電解研磨と前記研磨面およ

び前記研磨剤による化学機械研磨とを複合した電解複合研磨によって前記被研磨対象物に形成された金属膜を平坦化する請求項 33 に記載の研磨方法。

【請求項 35】前記被研磨対象物には、異なる材料からなる複数の膜が積層されており、前記各膜の材料の電気的特性の違いによって変化する前記電解液を通じて前記被研磨対象物の表面から前記研磨工具に流れる電解電流をモニタリングし、当該電解電流の大きさに基づいて研磨の進行を管理する請求項 33 に記載の研磨方法。

【請求項 36】前記研磨工具と前記被研磨対象物の表面との間に、所定の周期のパルス状の電圧を印加して前記電解電流を供給する請求項 33 に記載の研磨方法。

【請求項 37】電極部材を前記電解液が供給された前記被研磨対象物の表面に接近または当接させ、前記被研磨対象物の表面へ通電する請求項 33 に記載の研磨方法。

【請求項 38】前記電極部材を前記研磨工具とともに回転させ、かつ、前記被研磨対象物に対して相対移動させながら前記被研磨対象物に形成された金属膜に通電する請求項 37 に記載の研磨方法。

【請求項 39】前記被研磨対象物の表面を経由した前記電極部材と前記研磨工具との間の電気抵抗の大きさに基づいて、前記被研磨対象物の研磨の進行を管理する請求項 37 に記載の研磨方法。

【請求項 40】前記研磨剤に含まれる研磨砥粒を正に帯電させる請求項 34 に記載の研磨方法。

【請求項 41】被研磨対象物に形成された金属膜の表面に当該金属膜の電解反応を妨げる作用を発揮する不動態膜を形成する工程と、

導電性の研磨工具の研磨面と前記金属膜との間に電解液を介在させて当該研磨面と金属膜とを押し付け、かつ、前記研磨工具と前記金属膜と間に所定の電圧を印加する工程と、

前記研磨工具の研磨面と前記被研磨対象物の金属膜とを所定の平面に沿って相対移動させ、前記金属膜のうち前記研磨工具の研磨面に対して突出した凸部上の不動態膜を前記研磨工具の機械研磨によって選択的に除去する工程と、

前記不動態膜が除去されて表面に露出した金属膜の凸部を前記電解液による電解研磨作用によって除去して前記金属膜を平坦化する工程とを有する研磨方法。

【請求項 42】前記研磨面と前記金属膜との間に前記電解液とともに研磨砥粒を含む化学研磨剤を介在させ、前記研磨面および前記研磨砥粒による化学機械研磨によって前記不動態膜を選択的に除去する請求項 41 に記載の研磨方法。

【請求項 43】前記不動態膜は、前記金属膜の表面を酸化させた酸化膜からなる請求項 41 に記載の研磨方法。

【請求項 44】前記不動態膜は、前記金属膜を構成する金属の電解反応を妨げる作用を発揮する材料からなる膜

を前記金属膜の表面上に形成する請求項 41 に記載の研磨方法。

【請求項 45】前記不動態膜は、前記金属膜よりも、電氣的抵抗が高く、かつ、機械的強度が低い請求項 41 に記載の研磨方法。

【請求項 46】電極部材を前記金属膜の表面に接近または当接させ、前記金属膜へ通電する請求項 41 に記載の研磨方法。

【請求項 47】前記電極部材と前記研磨工具との間の電気抵抗の大きさに基づいて研磨の進行を管理する請求項 46 に記載の研磨方法。

【請求項 48】前記研磨剤に含まれる研磨砥粒を正に帯電させる請求項 42 に記載の研磨方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば、半導体装置の多層配線構造に伴う凹凸面を平坦化する研磨装置および研磨方法と多層配線構造をもつ半導体装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体装置の高集積化、小型化に伴い、配線の微細化、配線ピッチの縮小化、配線の多層化が進んでおり、半導体装置の製造プロセスにおける多層配線技術の重要性が増大している。一方、従来、多層配線構造の半導体装置の配線材料としてアルミニウム (Al) が多用されてきたが、最近の 0.25 μm ルール以下のデザインルールにおいて、信号の伝搬遅延を抑制するために、配線材料をアルミニウム (Al) から銅 (Cu) に代えた配線プロセスの開発が盛んに行われている。Cu を配線に使用すると、低抵抗と高エレクトロマイグレーション耐性を両立できるというメリットがある。この Cu を配線に使用したプロセスでは、たとえば、あらかじめ層間絶縁膜に形成した溝状の配線パターンに金属を埋め込み、CMP (Chemical Mechanical Polishing: 化学機械研磨) 法によって余分な金属膜を除去して配線を形成する、ダマシン (damascene) 法とよばれる配線プロセスが有力となっている。このダマシン法は、配線のエッチングが不要となり、さらに上の層間絶縁膜も自ずと平坦なものとなるので、工程を簡略化できるという特徴を有する。さらに、層間絶縁膜に配線だけでなく、コンタクトホールも溝として開け、配線とコンタクトホールを同時に金属で埋め込むデュアルダマシン (dual damascene) 法では、さらに大幅な配線工程の削減が可能となる。

【0003】ここで、上記のデュアルダマシン法による配線形成プロセスの一例について図 32～図 37 を参照して説明する。なお、配線材料として Cu を用いた場合について説明する。まず、図 32 に示すように、たとえば、図示しない不純物拡散領域が適宜形成されているシリコン等の半導体からなる基板 301 上に、たとえば、



シリコン酸化膜からなる層間絶縁膜302を、たとえば、減圧CVD(Chemical Vapour Deposition)法により形成する。次いで、図33に示すように、基板301の不純物拡散領域に通じるコンタクトホール303および基板301の不純物拡散領域と電気的に接続される所定パターンの配線が形成される溝304を公知のフォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いて形成する。次いで、図34に示すように、バリヤ膜305を層間絶縁膜302の表面およびコンタクトホール303、溝304内に形成する。このバリヤ膜305は、たとえば、Ta、Ti、Ta<sub>2</sub>N、TiN等の材料を公知のスパッタ法により形成する。バリヤ膜305は、配線を構成する材料が層間絶縁膜302中に拡散するのを防止するために設けられる。特に、配線材料がCuで層間絶縁膜302がシリコン酸化膜のような場合には、Cuはシリコン酸化膜への拡散係数が大きく、酸化されやすいため、これを防止する。

【0004】次いで、図35に示すように、バリヤ膜305上に、シードCu膜306を公知のスパッタ法により所定の膜厚で形成し、次いで、図36に示すように、コンタクトホール303および溝304をCuで埋め込むように、Cu膜307を形成する。Cu膜307は、たとえば、メッキ法、CVD法、スパッタ法等によって形成する。次いで、図37に示すように、層間絶縁膜302上の余分なCu膜307およびバリヤ膜305をCMP法によって除去し、平坦化する。これによって、配線308およびコンタクト309とが形成される。上記したプロセスを配線308上で繰り返し行うことにより、多層配線を形成することができる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記したデュアルダマシンプセスを用いた多層配線形成プロセスでは、余分なCu膜307およびバリヤ膜305をCMP法によって除去する工程において、層間絶縁膜302とCu膜307およびバリヤ膜305との除去性能が異なることから、配線308にディッシング、エロージョン(シンニング)、リセス等が発生しやすいという不利益が存在した。ディッシングは、図38に示すように、たとえば、0.18μmルールのデザインルールにおいて、たとえば、100μm程度のような幅の広い配線308が存在した場合に、当該配線の中央部が過剰に除去されへこんでしまう現象であり、このディッシングが発生すると配線308の断面積が不足するため、配線抵抗値不良等の原因となる。このディッシングは、配線材料に比較的軟質の銅やアルミニウムを用いた場合に発生しやすい。エロージョンは、図39に示すように、たとえば、3000μmの範囲に1.0μmの幅の配線が50パーセントの密度で形成されているようなパターン密度の高い部分が過剰に除去されてしまう現象であり、エロージョンが発生すると配線の断面積が不足するため、配線抵

抗値不良等の原因となる。リセスは、図40に示すように、層間絶縁膜302と配線308との境界で配線308が低くなり段差ができてしまう現象であり、この場合にも配線の断面積が不足するため、配線抵抗値不良等の原因となる。さらに、余分なCu膜307およびバリヤ膜305をCMP法によって除去する工程では、Cu膜307およびバリヤ膜305を効率的に除去する必要があり、単位時間当たりの除去量である研磨レートは、たとえば、500nm/min以上となるように要求されている。この研磨レートを稼ぐためにはウェーハに対する加工圧力を大きくする必要があり、加工圧力を大きくすると、図41に示すように、配線表面にスクラッチSCやケミカルダメージCDが発生しやすくなり、特に、軟質のCuやアルミニウムでは発生しやすい。このため、配線のオープン、ショート、配線抵抗値不良等の不具合の原因となり、また、加工圧力を大きくすると、上記のディッシング、エロージョン、リセスの発生量も大きくなるという不利益が存在した。

【0006】本発明は、上記した問題に鑑みてなされたものであって、たとえば、多層配線構造を有する半導体装置の配線等の金属膜を研磨によって平坦化する際に、初期凹凸を容易に平坦化でき、かつ余分な金属膜の除去効率に優れ、ディッシング、エロージョン等の金属膜の過剰な除去の発生を抑制可能な研磨装置および研磨方法、半導体装置の製造方法を提供する。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明の研磨装置は、研磨面を有し、導電性を有する研磨工具と、前記研磨工具を所定の回転軸を中心に回転させ、かつ、保持する研磨工具回転保持手段と、被研磨対象物を保持し所定の回転軸を中心に回転させる回転保持手段と、前記研磨工具を前記被研磨対象物に対向する方向の目標位置に移動位置決めする移動位置決め手段と、前記被研磨対象物の被研磨面と前記研磨工具の研磨面とを所定の平面に沿って相対移動させる相対移動手段と、前記被研磨対象物の被研磨面上に電解液を供給する電解液供給手段と、前記被研磨対象物の被研磨面を陽極とし前記研磨工具を陰極として、前記被研磨面から前記電解液を通じて前記研磨工具に流れる電解電流を供給する電解電流供給手段とを有する。

【0008】また、本発明の研磨装置は、被研磨対象物の被研磨面の全面に回転しながら接触する研磨面を有する研磨工具を備え、前記被研磨対象物を前記研磨面に回転させながら接触させて平坦化研磨する研磨装置であって、前記研磨面上に電解液を供給する電解液供給手段を有し、前記研磨面に前記被研磨対象物の被研磨面に通電可能な陽極電極および陰極電極を備え、前記電解液による電解研磨と前記研磨面による機械研磨とを複合した電解複合研磨によって前記被研磨対象物の被研磨面を平坦化研磨する。

【0009】本発明の研磨方法は、導電性の研磨工具の研磨面と金属膜が少なくとも表面または内層に形成された被研磨対象物の表面とを電解液を介在させて押し付け、前記研磨工具を陰極とし前記被研磨対象物の表面を陽極として、前記被研磨対象物の表面から前記研磨工具に前記電解液を通じて流れる電解電流を供給し、前記研磨工具と前記被研磨対象物とを共に回転させながら所定の平面に沿って相対移動させ、前記電解液による電解研磨および前記研磨面による機械研磨を複合した電解複合研磨によって前記被研磨対象物に形成された金属膜を平坦化する。

【0010】また、本発明の研磨方法は、被研磨対象物に形成された金属膜の表面に当該金属膜の電解反応を妨げる作用を発揮する不動態膜を形成する工程と、導電性の研磨工具の研磨面と前記金属膜との間に電解液を介在させて当該研磨面と金属膜とを押し付け、かつ、前記研磨工具と前記金属膜と間に所定の電圧を印加する工程と、前記研磨工具の研磨面と前記被研磨対象物の金属膜とを所定の平面に沿って相対移動させ、前記金属膜のうち前記研磨工具の研磨面に対して突出した凸部上の不動態膜を前記研磨工具の機械研磨によって選択的に除去する工程と、前記不動態膜が除去されて表面に露出した金属膜の凸部を前記電解液による電解研磨作用によって除去して前記金属膜を平坦化する工程とを有する。

【0011】本発明の半導体装置の製造方法は、基板上に形成された絶縁膜に配線を形成するための配線用溝を形成する工程と、前記配線用溝を埋め込むように、前記絶縁膜上に金属膜を堆積させる工程と、前記絶縁膜上に堆積した金属膜の表面に当該金属膜の電解反応を妨げる作用を発揮する不動態膜を形成する工程と、前記金属膜に形成された不動態膜のうち、前記配線用溝の埋め込みによって生じた前記金属膜の表面に存在する凸部上の不動態膜を機械研磨によって選択的に除去し、当該金属の凸部を表面に露出させる工程と、前記露出した金属膜の凸部を電解研磨によって除去し、前記配線用溝の埋め込みによって生じた前記金属膜の表面の凹凸を平坦化する工程とを有する。

【0012】また、本発明の半導体装置の製造方法は、前記表面が平坦化された金属膜の前記絶縁膜上に存在する余分な金属膜を電解研磨と機械研磨とを複合させた電解複合研磨によって除去し、前記配線を形成する工程をさらに有する。

【0013】本発明の半導体装置の製造方法では、表面に凹凸がある金属膜に不動態膜を形成し、不動態膜を機械的に除去することで、金属膜の凸部が表面に露出する。この金属膜の凸部は残った不動態膜をマスクとして電解液による電解作用によって選択的に溶出する。この結果、金属膜の初期凹凸が平坦化される。また、初期凹凸が平坦化された金属膜は、電解複合研磨によって高能率に除去され、たとえば、配線を形成する際に絶縁膜上

に存在する余分な金属膜は高能率に除去される。余分な金属膜が除去されて絶縁膜が露出すると、自動的にその部分の電解作用が停止し、絶縁膜に形成された配線用溝に埋め込まれた金属膜が過剰に除去されない。

【0014】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

#### 研磨装置の構成

図1は、本発明の一実施形態に係る研磨装置の構成を示す図である。図2は図1に示す研磨装置の加工ヘッド部の要部拡大図である。図1に示す研磨装置1は、加工ヘッド部2と、電解電源61と、研磨装置1全体を制御する機能を有するコントローラ55と、スラリー供給装置71と、電解液供給装置81とを備えている。なお、図示しないが、研磨装置1は、クリーンルーム内に設置され、当該クリーンルーム内には被研磨対象物としてのウェーハを収容したウェーハカセットを搬出入する搬出入ポートが設けられている。さらに、この搬出入ポートを通じてクリーンルーム内に搬入されたウェーハカセットと研磨装置1との間でウェーハの受け渡しを行うウェーハ搬送ロボットが搬出入ポートと研磨装置1との間に設置される。

【0015】加工ヘッド部2は、研磨工具3を保持し回転させ、研磨工具3を保持する研磨工具保持部11と、研磨工具保持部11をZ軸方向の目標位置に位置決めするZ軸位置決め機構部31と、被研磨対象物としてのウェーハWを保持し回転させX軸方向に移動するX軸移動機構部41とを備える。なお、研磨工具保持部11が本発明の研磨工具回転保持手段の一具体例に対応しており、X軸移動機構部41が本発明の回転保持手段および相対移動手段の一具体例に対応しており、Z軸位置決め機構部31は本発明の移動位置決め手段の一具体例に対応している。

【0016】Z軸位置決め機構部31は、図示しないコラムに固定されたZ軸サーボモータ18と、保持装置12および主軸モータ13に連結され、Z軸サーボモータ18に接続されたボールネジ軸18aに螺合するネジ部が形成されたZ軸スライダ16と、Z軸スライダ16をZ軸方向に移動自在に保持する図示しないコラムに設置されたガイドレール17とを有する。

【0017】Z軸サーボモータ18は、Z軸サーボモータ18に接続されたZ軸ドライブ52から駆動電流が供給されて回転駆動される。ボールネジ軸18aは、Z軸方向に沿って設けられ、一端がZ軸サーボモータ18に接続され、他端は、上記の図示しないコラムに設けられた保持部材によって回転自在に保持されている。これにより、Z軸位置決め機構部31は、Z軸サーボモータ18の駆動によって、研磨工具保持部11に保持された研磨工具3をZ軸方向の任意の位置に移動位置決めする。Z軸位置決め機構部31の位置決め精度は、たとえ

ば、分解能0.1 $\mu$ m程度としている。

【0018】X軸移動機構41は、ウェハWをチャッキングするウェハテーブル42と、ウェハテーブル42を回転自在に保持する保持装置45と、ウェハテーブル42を回転させる駆動力を供給する駆動モータ44と、駆動モータ44と保持装置45の回転軸とを連結するベルト46と、保持装置45に設けられた加工パン47と、駆動モータ44および保持装置45が設置されたX軸スライダ48と、図示しない架台に基台されたX軸サーボモータ49と、X軸サーボモータ49に接続されたボールネジ軸49aと、X軸スライダ48に連結されボールネジ軸49aに螺合するネジ部が形成された可動部材49bとを有する。

【0019】ウェハテーブル42は、たとえば、真空吸着手段によってウェハWを吸着する。加工パン47は、使用済の電解液や、スラリー等の液体を回収するために設けられている。駆動モータ44は、テーブルドライブ53から駆動電流が供給されることによって駆動され、この駆動電流を制御することでウェハテーブル42を所定の回転数で回転させることができる。X軸サーボモータ49は、X軸サーボモータ49に接続されたX軸ドライブ54から供給される駆動電流によって回転駆動し、X軸スライダ48がボールネジ軸49aおよび可動部材49bを介してX軸方向に駆動する。このとき、X軸サーボモータ49に供給する駆動電流を制御することによって、ウェハテーブル42のX軸方向の速度制御が可能となる。

【0020】図2は、研磨工具保持部11の内部構造の一例を示す図である。研磨工具保持部11は、研磨工具3と、研磨工具3を保持するフランジ部材4と、フランジ部材4を回転自在に保持する保持装置12と、保持装置12に保持された主軸12aと接続され当該主軸12aを回転させる主軸モータ13と、主軸モータ13上に設けられたシリンダ装置14とを備える。

【0021】主軸モータ13は、たとえば、ダイレクトドライブモータからなり、このダイレクトドライブモータの図示しないロータは、保持装置12に保持された主軸12aに連結されている。また、主軸モータ13は中心部にシリンダ装置14のピストンロッド14bが挿入される貫通孔を有している。主軸モータ13は、主軸ドライブ51から供給される駆動電流によって駆動される。

【0022】保持装置12は、たとえば、エアベアリングを備えており、このエアベアリングで主軸12aを回転自在に保持している。保持装置12の主軸12aも中心部にシリンダ装置14のピストンロッド14bが挿入される貫通孔を有している。

【0023】フランジ部材4は、金属材料から形成されており、保持装置12の主軸12aに連結され、底部に開口部4aを備え、下端面4bに研磨工具3が固着され

ている。フランジ部材4の上端面4c側は保持装置12に保持された主軸12aに連結されており、主軸12aの回転によってフランジ部材4も回転する。フランジ部材4の上端面4cは、主軸モータ13および保持装置12の側面に設けられた導電性の通電部材28に固定された通電ブラシ27と接触しており、通電ブラシ27とフランジ部材4とは電氣的に接続されている。

【0024】シリンダ装置14は、主軸モータ13のケース上に固定されており、ピストン14aを内蔵しており、ピストン14aは、たとえば、シリンダ装置14内に供給される空気圧によって矢印A1およびA2のいずれかの向きに駆動される。このピストン14aには、ピストンロッド14bが連結されており、ピストンロッド14bは、主軸モータ13および保持装置12の中心を通して、フランジ部材4の開口部4aから突き出ている。ピストンロッド14bの先端には、押圧部材21が連結されており、この押圧部材21はピストンロッド14bに対して所定の範囲で姿勢変更が可能な連結機構によって連結されている。押圧部材21は、対向する位置に配置された絶縁板22の開口22aの周縁部に当接可能となっており、ピストンロッド14bの矢印A2方向への駆動によって絶縁板22を押圧する。

【0025】シリンダ装置14のピストンロッド14bの中心部には、貫通孔が形成されており、貫通孔内に通電軸20が挿入され、ピストンロッド14bに対して固定されている。通電軸20は、導電性材料から形成されており、上端側はシリンダ装置14のピストン14aを貫通してシリンダ装置14上に設けられたロータリジョイント15まで伸びており、下端側は、ピストンロッド14bおよび押圧部材21を貫通して電極板23まで伸びており、電極板23に接続されている。

【0026】通電軸20は、中心部に貫通孔が形成されており、この貫通孔が化学研磨剤（スラリー）および電解液をウェハW上に供給する供給ノズルとなっている。また、通電軸20は、ロータリジョイント15と、電極板23とを電氣的に接続する役割を果たしている。

【0027】通電軸20の上端部に接続されたロータリジョイント15は、電解電極61のプラス極と電氣的に接続されており、このロータリジョイント15は通電軸20が回転しても通電軸20への通電を維持する。すなわち、通電軸20は回転してもロータリジョイント15によって電解電極61からプラスの電位が印加される。

【0028】通電軸20の下端部に接続された電極板23は、金属材料からなり、特に、ウェハWに形成される金属膜より貴なる金属で形成されている。電極板23は、上面側が絶縁板22に保持されており、電極板23の外周部は絶縁板22に嵌合しており、下面側にはスクラブ部材24が貼着されている。

【0029】ここで、図3(a)は電極板23の構造の一例を示す下面図であり、図3(b)は電極板23と、

通電軸20、スクラブ部材24および絶縁部材4との位置関係を示す断面図である。図3(a)に示すように、電極板23の中央部には円形の開口部23aが設けられており、この開口部23aを中心に電極板23の半径方向に放射状に伸びる複数の溝部23bが形成されている。また、図3(b)に示すように、電極板23の開口部23aには、通電軸20の下端部が嵌合固着されている。このような構成とすることで、通電軸20の中心部に形成された供給ノズル20aを通じて供給されるスラリーおよび電解液が溝部23bを通じてスクラブ部材24の全面に拡散するようになっている。すなわち、電極板23と、通電軸20、スクラブ部材24および絶縁部材4が回転しながら、スラリーおよび電解液が通電軸20の中心部に形成された供給ノズル20aを通じてスクラブ部材24の上側面に供給されると、スクラブ部材24の上側面全体にスラリーおよび電解液が広がる。なお、スクラブ部材24および通電軸20の供給ノズル20aが本発明の研磨剤供給手段および電解液供給手段の一具体例に対応している。また、電極板23、通電軸20およびロータリジョイント15が本発明の通電手段の一具体例に対応している。

【0030】電極板23の下面に貼着されたスクラブ部材24は、電解液およびスラリーを吸収し、これらを上側面から下側面に通過させることができる材料から形成されている。また、このスクラブ部材24は、ウェーハWに対向する面がウェーハWに接触してウェーハWをスクラブする面となっており、ウェーハW表面にスクラッチ等が発生させないように、たとえば、柔らかいブラシ状の材料、スポンジ状の材料、多孔質状の材料等から形成される。たとえば、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリビニルアセタール(PVA)などの樹脂からなる多孔質体が挙げられる。

【0031】絶縁板22は、たとえば、セラミクス等の絶縁材料から形成されており、この絶縁板22は複数の棒状の連結部材26によって保持装置12の主軸12aに連結されている。連結部材26は、絶縁板22の中心軸から所定の半径位置に等間隔に配置されており、保持装置12の主軸12aに対して移動自在に保持されている。このため、絶縁板22は主軸12aの軸方向に移動可能である。また、絶縁板22と主軸12aとの間には、各連結部材26に対応して、たとえば、コイルスプリングからなる弾性部材25で接続されている。

【0032】絶縁板22を保持装置12の主軸12aに対して移動自在にし、絶縁板22と主軸12aとを弾性部材25で連結する構成とすることにより、シリンダ装置14に高圧エアを供給してピストンロッド14bを矢印A2の向きに下降させると、押圧部材21が弾性部材25の復元力に逆らって絶縁板22を下方に押し下げ、これとともにスクラブ部材24も下降する。この状態からシリンダ装置14への高圧エアの供給を停止すると、

弾性部材25の復元力によって、絶縁板22は上昇し、これとともにスクラブ部材24も上昇する。

【0033】研磨工具3は、フランジ部材4の環状の下端面4bに固着されている。この研磨工具3は、ホイール状に形成されており、下端面に環状の研磨面3aを備えている。研磨工具3は、導電性を有しており、好ましくは、比較的軟質性の材料で形成する。たとえば、バインダマトリクス(結合剤)自体が導電性を持つカーボンや、あるいは、焼結銅、メタルコンパウンド等の導電性材料を含有するウレタン樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリビニルアセタール(PVA)などの樹脂からなる多孔質体から形成することができる。研磨工具3は、導電性を有するフランジ部材4に直接接続され、フランジ部材4に接触する通電ブラシ27から通電される。すなわち、主軸モータ13および保持装置12の側面に設けられた導電性の通電部材28は、電解電源61のマイナス極と電氣的に接続され、通電部材28に設けられた通電ブラシ27はフランジ部材4の上端面4cに接触しており、これにより、研磨工具3は電解電源61と通電部材28、通電ブラシ27およびフランジ部材4を介して電氣的に接続されている。

【0034】研磨工具3は、たとえば、図4に示すように、研磨面3aは中心軸に対して微小な角度で傾斜している。また、保持部材12の主軸12aもウェーハWの主面に対して研磨面3aの傾斜と同様に傾斜している。たとえば、保持部材12のZ軸スライダ16への取り付け姿勢を調整することで主軸12aの微小な傾斜をつくり出すことができる。このように、研磨工具3の中心軸がウェーハWの主面に対して微小角度で傾斜していることにより、研磨工具3の研磨面3aを所定の加工圧力FでウェーハWに押し付けた際に、研磨面3aのウェーハWに対する実効的な作用領域Sが図4に示すように、研磨工具3の半径方向に伸びる直線状の領域となる。このため、ウェーハWを研磨工具3に対してX軸方向に移動させて研磨下降を行う際に、図5(a)の状態から図5(b)に移動する間、実効的な作用領域Sの面積は略一定となる。本実施形態に係る研磨装置1では、研磨工具3の研磨面3aの一部を部分的にウェーハWの表面に作用させ、実効的作用領域SをウェーハWの表面に均一に走査させてウェーハWの全面を均一に研磨する。

【0035】電解電源61は、上記したロータリジョイント15と通電ブラシ12との間に所定の電圧を印加する装置である。ロータリジョイント15と通電ブラシ12との間に電圧を印加することによって、研磨工具3とスクラブ部材24の間には電位差が発生する。電解電源61には、常に一定の電圧を出力する定電圧電源ではなく、好ましくは、電圧を一定周期でパルス状に出力する、たとえば、スイッチング・レギュレータ回路を内蔵した直流電源を使用する。具体的には、パルス状の電圧を一定周期で出力し、パルス幅を適宜変更可能な電源を

使用する。一例としては、出力電圧がDC150V、最大出力電流が2~3A、パルス幅が1, 2, 5, 10, 20, 50 $\mu$ sのいずれかに変更可能なものを使用した。上記のような幅が短いパルス状の電圧出力とするのは、1パルス当たりの電解溶出量を非常に小さくするためである。すなわち、ウェーハWの表面に形成された金属膜の凹凸や接触した場合などにみられる極間距離の急変による放電、気泡やパーティクルなどが介在した場合におこる電気抵抗の急変によるスパーク放電など、金属膜の突発的なクレタ状の巨大溶出を防止、あるいは、できる限り抑制する小さなものの連続にするために有効である。また、出力電流に比して出力電圧が比較的高いため、極間距離の設定にある程度のマージンを設定する事ができる。すなわち、極間距離が多少変わっても出力電圧が高いため電流値変化は小さい。

【0036】電解電源61には、本発明の電流検出手段としての電流計62を備えており、この電流計62は、電解電源61に流れる電解電流をモニタするために設けられており、モニタした電流値信号62sをコントローラ55に出力する。また、電解電源61は、本発明の抵抗値検出手段としての抵抗計63を備えており、この抵抗計63は電解電源61に流れる電流に基づいて、ウェーハWの表面を経由した研磨工具3と電極板23との間の電気抵抗をモニタリングするために設けられており、モニタリングした電気抵抗値信号63sをコントローラ55に出力する。

【0037】スラリー供給装置71は、スラリーを上記の通電軸20の供給ノズル20aに供給する。スラリーとしては、金属膜の研磨用として、たとえば、過酸化水素、硝酸鉄、ヨウ素酸カリウム等をベースとした酸化力のある水溶液に酸化アルミニウム（アルミナ）、酸化セリウム、シリカ、酸化ゲルマニウム等を研磨砥粒として含有させたものを使用する。また、研磨砥粒は、分散性を良くしてコロイド状態を保持するために予め正に帯電させておく。

【0038】電解液供給装置81は、電解液ELを加工ヘッド部11に供給する。電解液ELは、溶媒とイオン的に分離した溶質とからなる溶液である。この電解液として、たとえば、硝酸塩あるいは塩化物系に還元剤を調整した水溶液を使用することができる。

【0039】コントローラ55は、研磨装置1の全体を制御する機能を有し、具体的には、主軸ドライバ51に対して制御信号51sを出力して研磨工具3の回転数を制御し、Z軸ドライバ52に対して制御信号52sを出力して研磨工具3のZ軸方向の位置決め制御を行い、テーブルドライバ53に対して制御信号53sを出力してウェーハWの回転数を制御し、X軸ドライバ54に対して制御信号54sを出力して、ウェーハWのX軸方向の速度制御を行う。また、コントローラ55は、電解液供給装置81およびスラリー供給装置71の動作を制御

し、加工ヘッド部2への電解液ELおよびスラリーSLの供給動作を制御する。

【0040】また、コントローラ55は、電解電源61の出力電圧、出力パルスの周波数、出力パルスの幅等を制御可能となっている。また、コントローラ55には、電解電源61の電流計62および抵抗計63からの電流値信号62sおよび電気抵抗値信号63sが入力される。コントローラ55は、これら電流値信号62sおよび電気抵抗値信号63sに基づいて、研磨装置1の動作を制御可能となっている。具体的には、電流値信号62sから得られた電解電流が一定となるように、電流値信号62sをフィードバック信号としてZ軸サーボモータ18の制御したり、電流値信号62sまたは電気抵抗値信号63sで特定される電流値、電気抵抗値の値に基づいて、研磨加工を停止させるように研磨装置1の動作を制御する。

【0041】コントローラ55に接続されたコントロールパネル56は、オペレータが各種のデータを入力したり、たとえば、モニタリングした電流値信号62sおよび電気抵抗値信号63sを表示したりする。

【0042】次に、上記した研磨装置1による研磨動作をウェーハW表面に形成された金属膜を研磨する場合を例に説明する。なお、ウェーハWの表面には、たとえば、銅からなる金属膜が形成されている場合について説明する。まず、ウェーハテーブル45にウェーハWをチャッキングし、ウェーハテーブル45を駆動して所定の回転数でウェーハWを回転させる。また、ウェーハテーブル45をX軸方向に移動して、フランジ部4に取り付けられた研磨工具3をウェーハWの上方の所定位置に位置させ、研磨工具3を所定の回転数で回転させる。研磨工具3を回転させると、フランジ部4に連結された絶縁板22、電極板23およびスクラブ部材24も回転駆動される。また、スクラブ部材24を押圧している押圧部材21、ピストンロッド14b、ピストン14a、通電軸20も同時に回転する。

【0043】この状態から、スラリー供給装置71および電解液供給装置81からそれぞれスラリーSLおよび電解液ELを通電軸20内の供給ノズル20aに供給すると、スクラブ部材24の全面からスラリーSLおよび電解液ELが供給される。研磨工具3をZ軸方向に下降させて研磨工具3の研磨面3aをウェーハWの表面に接触させ、所定の加工圧力で押圧させる。また、電解電源61を起動させて、通電ブラシ27を通じて研磨工具3にマイナスの電位を印加し、ロータリジョイント15を通じてスクラブ部材24にプラスの電位を印加する。

【0044】さらに、シリンダ装置14に高圧エアを供給して、図1の矢印A2の方向にピストンロッド14bを下降させ、スクラブ部材24の下面をウェーハWに接触あるいは接近する位置まで移動させる。この状態からウェーハテーブル45をX軸方向に所定の速度パターン

で移動させ、ウェーハWの全面を一様に研磨加工する。

【0045】ここで、図6は、研磨装置1において研磨工具3をZ軸方向に下降させ、ウェーハWの表面に接触させた状態を示す概略図であり、図7は図6の円C内の拡大図であり、図8は図7の円D内の拡大図である。図7に示すように、スクラブ部材24はウェーハWに形成された金属膜MTに、ウェーハW上に供給された電解液ELを介して、または、直接接触することにより陽極として通電し、研磨工具3もウェーハWに形成された金属膜MTに、ウェーハW上に供給された電解液ELを介して、または、直接接触することにより陰極として通電する。なお、図7に示すように、金属膜MTとスクラブ部材24との間には、ギャップ $\delta b$ が存在している。さらに、図8に示すように、金属膜MTと研磨工具3の研磨面3aとの間にはギャップ $\delta w$ が存在している。図7に示すように、絶縁板4は、研磨工具3とスクラブ部材24（電極板23）との間に介在しているが、絶縁板4の抵抗R0は非常に大きく、したがって、スクラブ部材24から絶縁板4を介して研磨工具3に流れる電流i<sub>1</sub>はほぼ零であり、スクラブ部材24から絶縁板4を介して研磨工具3には電流が流れない。

【0046】このため、スクラブ部材24から研磨工具3に流れる電流は、直接電解液EL中の抵抗R1を経由して研磨工具3に流れる電流i<sub>1</sub>と、電解液EL中からウェーハWの表面に形成された銅からなる金属膜MTを経由して再度電解液EL中を通して研磨工具3に流れる電流中に流れる電流i<sub>2</sub>に分岐する。金属膜MTの表面に電流i<sub>2</sub>が流れると、金属膜MTを構成する銅は、電解液ELの電解作用によってイオン化し、電解液EL中に溶出する。

【0047】ここで、電解液EL中の抵抗R1は、陽極としてのスクラブ部材24と陰極としての研磨工具3との距離dに比例して極端に大きくなる。このため、極間距離dを、ギャップ $\delta b$ およびギャップ $\delta w$ よりも十分に大きくしておくことで、直接電解液EL中の抵抗R1を経由して研磨工具3に流れる電流i<sub>1</sub>は非常に小さくなり、電流i<sub>2</sub>が大きくなって、電解電流のほとんどは金属膜MTの表面経由することになる。このため、金属膜MTを構成する銅の電解溶出を効率的に行うことができる。また、電流i<sub>2</sub>の大きさは、ギャップ $\delta b$ およびギャップ $\delta w$ の大きさによって変化するため、上述したように、コントローラ55によって研磨工具3のZ軸方向の位置制御を行ってギャップ $\delta b$ およびギャップ $\delta w$ の大きさを調整することにより、電流i<sub>2</sub>を一定にすることができる。ギャップ $\delta w$ の大きさの調整は、電流値信号62sから得られた電解電流、すなわち、電流i<sub>2</sub>が一定となるように、電流値信号62sをフィードバック信号としてZ軸サーボモータ18の制御を行うことで可能である。また、研磨装置1のZ軸方向の位置決め精度は分解能0.1 $\mu$ mと十分に高く、加えて、主軸12

aをウェーハWの主面に対して微小角度で傾斜させていることで実行的な接触面積Sは常に一定に維持されることから、電解電流の値を一定に制御すれば、電流密度は常に一定とでき、金属膜の電解溶出量も常に一定にすることができる。

【0048】以上のように、上記構成の研磨装置1は、上述したウェーハWに形成された金属膜MTを構成する金属を電解液ELによる電解作用によって溶出除去する電解研磨機能を備えている。さらに、上記構成の研磨装置1は、この電解研磨機能に加えて、研磨工具3およびスラリーSLによる通常のCMP装置の化学機械研磨機能も備えており、ウェーハWをこれら電解研磨機能および化学機械研磨の複合作用によって研磨すること（以下、電解複合研磨という）もできる。また、上記構成の研磨装置1は、スラリーSLを用いずに研磨工具3の研磨面3aの機械的な研磨と電解研磨機能との複合作用によって研磨加工を行うこともできる。上記構成の研磨装置1は、電解研磨および化学機械研磨の複合作用によって金属膜を研磨できるため、化学機械研磨のみ、あるいは、機械研磨のみを用いた研磨装置に比べてはるかに高効率に金属膜の除去を行うことができる。金属膜に対する高い研磨レートが得られるため、研磨工具3のウェーハWに対する加工圧力Fを化学機械研磨のみ、あるいは機械研磨のみを用いた研磨装置に比べて低く抑えることが可能となり、ディッシング、エロージョンの発生を抑制することができる。

【0049】以下、本実施形態に係る研磨装置1の電解複合研磨機能を用いた研磨方法について、多層配線構造の半導体装置のデュアルダマシン法による配線形成プロセスに適用した場合を例に説明する。

【0050】図9は、本発明の半導体装置の製造方法の一実施形態に係る製造プロセスを示す工程図であり、図9に示す工程図に基づいて本実施形態に係る製造プロセスを説明する。まず、図10に示すように、たとえば、図示しない不純物拡散領域が適宜形成されている、たとえば、シリコン等の半導体からなるウェーハW上に、たとえば、シリコン酸化膜(SiO<sub>2</sub>)からなる層間絶縁膜102を、たとえば、反応源としてTEOS(tetraethylorthosilicate)を用いて減圧CVD(Chemical Vapor Deposition)法により形成する。次いで、図11に示すように、ウェーハの不純物拡散領域に通じるコンタクトホール103およびウェーハWの不純物拡散領域と電氣的に接続される所定パターンの配線が形成される配線用溝104を、たとえば、公知のフォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いて形成する。なお、配線用溝104の深さは、たとえば、800nm程度である。

【0051】次いで、図12に示すように、バリヤ膜105を層間絶縁膜102の表面およびコンタクトホール103、配線用溝104内に形成する。このバリヤ膜3

05は、たとえば、Ta、Ti、Ta<sub>2</sub>N、TiN等の材料をスパッタリング装置、真空蒸着装置等を用いたPVD(Physical Vapor Deposition)法により、たとえば、15nm程度の膜厚で形成する。バリア膜305は、配線を構成する材料が層間絶縁膜102中に拡散するのを防止するため、および、層間絶縁膜102との密着性を上げるために設けられる。特に、配線材料が銅で層間絶縁膜102がシリコン酸化膜のような場合には、銅はシリコン酸化膜への拡散係数が大きく、酸化されやすいため、これを防止する。以上までのプロセスが図9に示すプロセスPR1である。

【0052】次いで、図13に示すように、バリア膜105上に、配線形成材料と同じ材料、たとえば、銅からなるシード膜106を公知のスパッタ法により、たとえば、150nm程度の膜厚で形成する(プロセスPR2)。シード膜106は、銅を配線用溝およびコンタクトホール内に埋め込んだ際に、銅グレインの成長を促すために形成する。次いで、図14に示すように、コンタクトホール103および配線用溝104を埋め込むように、バリア膜105上に銅からなる金属膜107を、たとえば、2000nm程度の膜厚で形成する。金属膜107は、好ましくは、電解メッキ法または無電解メッキ法によって形成するが、CVD法、スパッタ法等によって形成してもよい。なお、シード膜106は金属膜107と一体化する(プロセスPR3)。

【0053】ここで、図15は金属膜107をバリア膜105上に形成した製造プロセス途中の半導体装置の断面の拡大図である。図15に示すように、金属膜107の表面には、コンタクトホール103および配線用溝104への埋め込みのために、たとえば、600nm程度の高さの凹凸が発生している。以上のプロセスは、従来と同様のプロセスで行われるが、本発明の研磨方法では、層間絶縁膜102上に存在する余分な金属膜107およびバリア膜105の除去を化学機械研磨ではなく、上記の研磨装置1の電解複合研磨によって行う。また、本発明の研磨方法では、上記の電解複合研磨によるプロセスに先立って、図16に示すように、金属膜107の表面に不動態膜108を形成する(プロセスPR4)。この不動態膜108は、金属膜107を構成する金属(銅)の電解反応を妨げる作用を発揮する材料からなる膜である。

【0054】不動態膜108の形成方法は、たとえば、金属膜107の表面に酸化剤を塗布して酸化膜を形成する。金属膜107を構成する金属が銅の場合には、酸化銅(Cu<sub>2</sub>O)が不動態膜108となる。また、他の方法として、金属膜107の表面に、たとえば、はっ水膜、油膜、酸化防止膜、界面活性剤からなる膜、キレート剤からなる膜、および、シランカップリング剤からなる膜のいずれかを形成して不動態膜108とすることも可能である。不動態膜108の種類は特に限定されないが、

電気抵抗が金属膜107に対して高く、機械的強度が比較的強く脆い性質のものを使用する。

【0055】次に、本発明の研磨方法では、金属膜107の凸部に形成された不動態膜108のみを選択的に除去する(プロセスPR5)。不動態膜108の選択的な除去は、上記の研磨装置1によって行う。なお、使用するスラリーSLには、銅に対する研磨レートの高いスラリーを用いる。たとえば、過酸化水素、硝酸鉄、ヨウ素酸カリウム等をベースとした水溶液にアルミナ、シリカ、マンガン系の研磨砥粒を含むものを使用する。まず、ウェーハWを研磨装置1のウェーハテーブル42にチャッキングし、電解液ELおよびスラリーSLをウェーハW上に供給しながら回転する研磨工具3およびスクラブ部材24をZ軸方向に下降させてウェーハWに接触または接近させ、ウェーハWをX軸方向に所定の速度パターンで移動させて研磨加工を行う。また、研磨工具3にマイナス極、電極板23をプラス極として、研磨工具3と電極板23との間に直流パルス電圧を印加する。なお、スラリーSLのベースとなる水溶液に電解液SLの機能を持たせることにより、スラリーSLのみをウェーハW上に供給してもよい。

【0056】ここで、図17は上記の状態にあるスクラブ部材24付近における研磨プロセスを示す概念図であり、図18は研磨工具3付近における研磨プロセスを示す概念図である。図17に示すように、スクラブ部材24付近では、回転する電極板23の溝部23bからスラリーSLおよび電解液ELが供給されて、スラリーSLおよび電解液ELはスクラブ部材24を通過してスクラブ部材24の全面からウェーハW上に供給される。金属膜107上に形成された不動態膜108は、電解液ELによる電解作用を受けないため電解液EL中への金属膜107を構成する銅の溶出は抑制された状態にある。このため、金属膜107には電流がほとんど流れず、上記の電流計62のモニタした電流値は、低く安定したままである。図25は、本実施形態の電解複合研磨プロセスにおいて電流計62でモニターした電流値の一例を示すグラフである。図25に示す電流値の開始位置付近が上記の状態である。

【0057】スクラブ部材24の回転にしたがって、機械的除去作用あるいはスラリーSLに含まれる、たとえば、酸化アルミニウムからなる研磨砥粒PTの機械的除去作用によって不動態膜108の高い部分、すなわち、金属膜107の凸部上の不動態膜108から機械的に除去されていく。一方、図18に示すように、研磨工具3付近では、研磨工具3の機械的除去作用、あるいは、研磨砥粒PTの機械的除去作用によって金属膜108に存在する不動態膜108が高い部分から除去される。

【0058】このようにして、たとえば、図19に示すように、金属膜107の凸部上に形成された不動態膜108が選択的に除去されると、不動態膜108が選択的



に除去された部分から金属膜107が表面に露出する。

【0059】金属膜107が表面に露出すると、凸部である金属膜107の露出部分が選択的に溶出する（プロセスPR5）。このときの電解液ELの作用は、図18に示すように、不動態膜108が除去された部分である金属膜107の凸部は、金属膜107を構成する銅が電解作用によって銅イオン $Cu^{+}$ として電解液EL中に溶出する。これによって、金属膜107中にはマイナス電子 $e^{-}$ が流れ、このマイナス電子 $e^{-}$ は、図17に示したように、金属膜107の表面から電解液ELを通して電極板23に流れ、上記した電流 $i_2$ となる。

【0060】上述したように、金属膜107を構成する銅は、不動態膜108に比べて電気抵抗が低く電流密度が増すため、集中的な電解作用を受け選択的に溶出がおり、材料除去が加速される。また、電解液ELを介して通電するため、陽極としての金属膜107と陰極としての研磨工具3の電位差が一定の場合、極間距離が短い、すなわち、電気抵抗値が低いほうが極間に流れる電流値は大きくなる。このため、陰極としての研磨工具3に対して、陰極としての金属膜107の凹凸による電極間距離の差（金属膜107の凸部のなかでも高い部分のほうが極間距離が短く電気抵抗が低い）があれば、電流密度の違いから高い順に溶出速度が大きくなる効率的な平坦化が進行する。このとき、図25において、P1で示すように、上記の電流計62のモニターした電流値は上昇しはじめる。このような作用によって、金属膜107の凸部は、機械的平坦化に比べて、はるかに高能率に平坦化が行われる。

【0061】上記の作用によって、金属膜107の凸部がほぼ完全に平坦化されるまで選択的な電解複合研磨が完了した金属膜107の表面は、たとえば、図20に示すように、金属膜107の凹部であった部分に残存する不動態膜108と金属膜107の凸部が除去された銅の新生面の複合面になる。

【0062】続いて、図21に示すように、この金属膜107の表面に研磨工具3およびスラリーSL中の研磨砥粒PTにより行われる機械的除去と電解液ELによる電解作用が複合した電解複合研磨が進行する（プロセスPR7）。このとき、残存する不動態膜108の機械的強度は上述したように銅の新生面に比べて低いため、不動態膜108が電解複合研磨されるとき、主に機械的作用により除去され、その下にある銅表面が露出し、その面積に比例して電解作用が増大する。不動態膜108が完全除去された時点で金属膜107を構成する銅の表面積は最大となる。これと同時に、電流計62でモニターした電流は、図25においてP1の位置から上昇した電流値は、不動態膜108の除去に伴って上昇した後、銅の表面積が最大となるP2で示す時点で最大値となる。ここまでのプロセスによって、金属膜107の表面の初期凹凸の平坦化は完了する。

【0063】このように、本実施形態の電解複合研磨は、電気化学的に研磨レートをアシストされた研磨であるため、通常の化学機械研磨に比べて低い加工圧力で研磨を行うことができる。このことは、単純な機械的研磨として比較してもスクラッチの低減、段差緩和性能、ディッシングやエロージョンの低減などの面で非常に有利である。さらに、低い加工圧力で研磨を行うことができるため、機械強度が低く通常の化学機械研磨では破壊されてしまい易い、有機系の低誘電率膜や多孔質低誘電率絶縁膜を層間絶縁膜102に用いていた場合に非常に有利である。

【0064】上記の金属膜107の電解複合研磨が進行して、余分な金属膜107が除去されると、図22に示すように、バリア膜105が露出する（プロセスP8）。このとき、電流計62のモニターする電流は、図25のP2で示す金属膜107上の不動態膜108がすべて除去された時点より最大値をとり、図25のP3で示すバリア膜105が露出する時点まで略一定の値をとる。バリア膜105が露出すると、たとえば、Ta、Ti、Ta<sub>2</sub>N、TiN等の材料を使用した場合には、その電気抵抗が銅に比べ大きいため、たとえば、図25のバリア膜105の露出が開始するP3で示す時点から電流計62でモニターした電流値が低下しはじめる。この状態では、金属膜107の不均一分の銅膜が残留する状態であり、この状態で研磨加工を一旦停止する。この研磨加工の停止は、図25のP4で示すように電流値が所定の値まで下がったことをコントローラ55が判断し、研磨装置1の研磨動作を停止させる。

【0065】次いで、バリア膜105を除去する（プロセスPR9）。このバリア膜105を除去するプロセスでは、上記の銅から構成される金属膜107に対して研磨レートの高いスラリーSLではなく、Ta、Ta<sub>2</sub>N、Ti、TiN等の材料から形成されたバリア膜105に対して研磨レートが高く、金属膜107に対して研磨レートの低いスラリーSLを使用する。すなわち、バリア膜105と金属膜107の研磨レートの選択比ができるだけ大きなスラリーSLを使用する。

【0066】さらに、オーバーポリッシュによるディッシング、エロージョンの発生を抑制する観点等から、電解電源61の出力電圧を上記のプロセスよりも小さくしてバリア膜105の研磨除去を行う。また、研磨工具3の加工圧力も上記のプロセスよりも小さくするのが好ましい。また、電解電源61の出力電圧を小さくすること、および、バリア膜105を除去すると層間絶縁膜102が表面に露出することから、電解電流の値は小さくなるので、上記の電流計62による電解電流のモニタに代えて、上記の抵抗計63によってスクラブ部材24と研磨工具3との間に電気抵抗をモニターする。

【0067】バリア膜105を除去すると、図23に示すように、層間絶縁膜102が表面に露出する（プロセ



SP10)。層間絶縁膜102が露出すると、図23に示すように、この露出部分には、陽極として表面に通電するための金属膜107やバリア膜105がないため、スクラップ部材24による通電が遮断され、層間絶縁膜102の露出部分での電解作用が停止する。このとき、抵抗計63によってモニターした電気抵抗値は増加しはじめる。

【0068】ここで、金属膜107の残存する部分とバリア膜105の露出部分との間で、上記した金属膜107の凸部の段差緩和の場合と同様に、すなわち、不働態膜108の代りにバリア膜105を電気抵抗の高い部分として、金属膜107の残存部分への電流密度の集中がおこり選択的に金属膜107の残存部分は溶出除去される。電解作用の停止した部分には、研磨工具3とスラリーSLによる機械的な材料除去作用のみが主体的に働く。

【0069】ところで、通常の化学機械研磨では、バリア膜105および金属膜107の層間絶縁膜102に対する研磨レート選択比をできるだけ大きくし、そのレート差をマージンとして層間絶縁膜102の上面の寸法精度を確保しようとしている。このため、金属膜107のディッシングは避けられない構成となっている。また、選択比を低く設定すればディッシングはある程度少なくすることができるが、寸法精度は、ウェーハ面内除去量分布の均一性に依存するため、バリア膜105および金属膜107の除去が十分ではない場合も発生する。このため、バリア膜105および金属膜107が層間絶縁膜102の上面に残存した状態であるアンダーポリッシュを防ぐためには、除去量の面内不均一分のオーバーポリッシュが必要となり、このオーバーポリッシュによるエロージョンの悪化は本質的に避けられない。一方、本実施形態では、ウェーハWの面内均一性をある程度確保しておけば、層間絶縁膜102上に残るバリア膜105、あるいは、金属膜107の残存部分には電解作用が働くことで高能率除去され、層間絶縁膜102の露出部分から溶出が停止する。このため、層間絶縁膜102の寸法精度は自動的に確保され、ディッシング、エロージョンの発生が抑制される。

【0070】上記のようにして、たとえば、Ta、Ta<sub>2</sub>N<sub>5</sub>、Ti、TiN等の材料から形成されたバリア膜105を完全に除去することができるとともに、オーバーポリッシュによるディッシング、エロージョンの発生を抑制することができる。また、上述したバリア膜105の除去プロセスでは、絶対電流値は低く、機械的負荷も軽く設定することで除去速度は遅くなるが、残存する膜厚が不均一な部分の残留分の銅膜からなる金属膜107が少なければ、バリア膜105は金属膜107に比べて薄いいためバリア膜105の除去量自体は小さく、このプロセスにおいてバラツキ・不均一があったとしてもディッシング、エロージョンの絶対値は無視できる程度に少な

くでき、処理時間も短くすることができる。さらに、本実施形態に係る研磨方法は、機械的研磨に加えて電気化学的作用が付加された複合加工であるため、平坦化した表面はダメージが少なく機械的にも平滑な面を得ることができる。

【0071】次いで、抵抗計63でモニターした電気抵抗値に基づいて、電気抵抗値が最大値すなわち配線形成が完了した時点でバリア膜105を除去するプロセスを終了する(プロセスPR11)。コントローラ55は電気抵抗値の値を判断して、研磨装置1の加工動作を停止させる。なお、研磨加工を終了する前に、電解作用を付加したままの状態、研磨工具3をウェーハWの表面に接触させず、例えば、100μm程度上を通過させることで、機械的研磨は行わず、電解作用のみによるダメージフリーの表面を形成することができる。これにより、図23に示すように、層間絶縁膜102中には配線109およびコンタクト110が最終的に形成される。

【0072】次いで、配線109およびコンタクト110が形成された半導体装置に対してフラッシングを行う(プロセスPR12)。このフラッシングプロセスは、配線109およびコンタクト110が形成された後、直ぐに洗浄薬液、酸化防止剤をウェーハWの表面に供給しながら、ウェーハWには通電せず、図24に示すように、研磨工具3にプラスのバース電圧を印加し、純水洗浄、薬液洗浄を行い、ウェーハWの表面に存在するスラリーSLやパーティクルを除去する。本実施形態では、フラッシングを行う以前にも、スラリーSLに含まれる、たとえば、アルミナからなる研磨砥粒PTは分散性をよくするために正に帯電させているため、銅からなる金属膜107表面に機械的に衝突して除去加工に寄与したのち摩滅せずに残留した場合にも、陽極としての金属膜107を構成する銅の表面に埋没することはない、図23に示したように、陰極としての研磨工具3の表面に再付着して次の加工に寄与する。さらに、正に帯電したパーティクルも陰極としての研磨工具3の表面に引き寄せられるため、銅の表面に埋没することはない。一方、ウェーハWの表面に残存して負に帯電しているパーティクルも上記のフラッシングによって、ウェーハWの表面から除去することができる。また、研磨砥粒PTが負に帯電したスラリーSLを使用した場合にも同様に除去できる。配線形成材料が銅である場合、酸化されやすく、銅表面を変質させずに、金属イオンやパーティクルを除去する必要があるが、本実施形態では、予め研磨砥粒PTを正に帯電させておき、かつ、フラッシングによってこの問題が解消される。なお、研磨砥粒として、酸化アルミニウム(アルミナ)を例として挙げたが、酸化セリウム、シリカ、酸化ゲルマニウムなどを使用した場合にも同様である。

【0073】以上のように、本実施形態に係る半導体装置の製造方法によれば、絶縁膜102内に形成した配線

用溝配線およびコンタクトホールを埋め込む金属膜107に不動態膜108を形成し、金属膜107の凸部に形成された不動態膜108を選択的に除去し、残った不動態膜108をマスクとして表面に露出した金属膜107を電解研磨によって選択的に除去し、かつ電流密度に集中によって集中的に除去することで、通常のCMPに比べてはるかに高能率に初期凹凸を平坦化することができる。また、初期凹凸が平坦化された金属膜107は、電解研磨と化学機械研磨の複合した電解複合研磨によって除去されるため、通常のCMPに比べてはるかに高能率に余分な金属膜107を除去できる。このため、研磨工具3の加工圧力を低く設定しても十分な研磨レートが得られ、金属膜107へのダメージを軽減できるとともに、ディッシングやエロージョンの発生を抑制することができる。

【0074】また、本実施形態に係る半導体装置の製造方法によれば、余分な金属膜107を除去してバリア膜105が露出した時点で、研磨を停止し、スラリーSLをバリア膜105に対して研磨レートの高いものに変更し、電解電源61の出力電圧等の研磨条件を変更して余分なバリア膜105を除去を行うため、余分なバリア膜105を確実に除去でき、オーバポリッシュが必要な場合にも、ディッシングやエロージョンの発生量を小さく抑えることができる。

【0075】また、本実施形態に係る半導体装置の製造方法によれば、金属膜の研磨を電解複合研磨によって高能率に行うため、研磨工具3の加工圧力を低圧力にすることができるため、たとえば、低消費電力化および高速化等の観点から誘電率を低減するために層間絶縁膜102として機械的強度が比較的低い有機系低誘電率膜や多孔質低誘電率絶縁膜を使用した場合にも、これらの絶縁膜へのダメージを低減することができる。

【0076】上述した実施形態では、金属膜の研磨加工量の絶対値は、電解電流の積算量と研磨工具3のウェーハWを通過する時間で制御できる。上述した実施形態では、銅による配線形成プロセスの場合を説明したが、本発明はこれに限定されることなく、タングステン、アルミニウム、銀等の種々の金属配線形成プロセスに適用可能である。

【0077】また、上述した実施形態では、スラリーSLを用いた化学機械研磨と電解液ELを用いた電解研磨とを複合した電解複合研磨の場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。すなわち、本発明は、スラリーSLを用いずに、電解液ELの電解研磨と研磨工具3の研磨面3aによる機械研磨によって電解複合研磨を行うことも可能である。

【0078】また、上述した実施形態では、研磨工具3と電極板23との間を流れる電流値をモニターし、この値に基づいてバリア膜105が露出するまでの研磨プロセスを管理したが、全ての研磨プロセスをモニターした

電流値で管理することも可能である。同様に、上述した実施形態では、研磨工具3と電極板23との間の電気抵抗値をモニターし、この値に基づいて、バリア膜105の除去プロセスのみの管理を行う構成としたが、全ての研磨プロセスをモニターした電気抵抗値で管理することも可能である。

#### 【0079】変形例1

図26は、本発明に係る研磨装置の一変形例を示す概略図である。上述した実施形態に係る研磨装置1では、ウェーハW表面への通電を、導電性の研磨工具と、スクラブ部材24を備えた通電板23とによって行った。図26に示すように、ホイール状の研磨工具401は、研磨装置1の場合と同様に導電性を持たせるとともに、ウェーハWをチャッキングし回転させるウェーハテーブル402にも導電性を持たせる構成としてもよい。研磨工具401への給電は、上述した実施形態と同様の構成で行う。この場合には、ウェーハテーブル402への通電は、ウェーハテーブル402の下部にロータリージョイント403を設け、ロータリージョイント403によって回転するウェーハテーブル402への通電を常に維持する構成とすることで、電解電流の供給を行うことができる。

#### 【0080】変形例2

図27は、本発明に係る研磨装置の他の変形例を示す概略図である。ウェーハWをチャッキングし、回転させるウェーハテーブル502は、ウェーハWをウェーハWの周囲に設けたリテーナリング504によって保持している。研磨工具501には、導電性を持たせるとともに、リテーナリング504にも導電性を持たせ、研磨工具501には上述した実施形態と同様の構成で給電する。また、リテーナリング504は、ウェーハWに形成された上記のバリア層部分まで覆い通電する。さらに、リテーナリング504には、ウェーハテーブル502の下部に設けられたロータリジョイント503を通じて給電する。なお、研磨工具501がウェーハWに接触しても、エッジの部分でリテーナリング504の厚さ以上の隙間が維持できるように研磨工具3の傾斜量を大きくしておくことで、研磨工具501とリテーナリング504との干渉を防ぐことができる。

#### 【0081】変形例3

図28は、本発明に係る研磨装置の他の実施形態を示す概略構成図である。図28に示す研磨装置は、従来型のCMP装置に本発明の電解研磨機能を付加したものであって、定盤201上に研磨パッド(研磨布)202が貼着された研磨工具の研磨面にウェーハチャック207によってチャッキングされたウェーハWの全面を回転させながら接触させてウェーハWの表面を平坦化する研磨装置である。研磨パッド202には、陽極電極204と陰極電極203とが放射状に交互に配置されている。また、陽極電極204と陰極電極203とは絶縁体206

によって電氣的に絶縁されており、陽極電極 204 と陰極電極 203 は、定盤 201 側から通電される。これら陽極電極 204 と陰極電極 203 と絶縁体 206 とによって研磨パッド 202 は構成されている。また、ウェーハチャック 207 は、絶縁材料から形成されている。さらに、この研磨装置には、研磨パッド 202 の表面に電解液 E L およびスラリー S L を供給する供給部 208 が設けられており、電解研磨および化学機械研磨を複合させた電解複合研磨が可能になっている。

【0082】ここで、図 29 は、上記構成の研磨装置による電解複合研磨動作を説明するための図である。なお、ウェーハ W 表面には、たとえば、銅膜 210 が形成されているものとする。図 29 に示すように、電解複合研磨中には、ウェーハ W 表面に形成された銅膜 210 と研磨パッド 202 の研磨面との間には、電解液 E L およびスラリー S L が介在した状態で、陽極電極 204 と陰極電極 203 との間に直流電圧が印加され、電流  $i$  が陽極電極 204 から電解液 E L を通って銅膜 210 内を伝って再び電解液 E L を通って陰極電極 203 に流れる。このとき、図 29 に示す円 G 内の付近では、電解作用によって銅膜 210 が溶出するとともに、銅膜 210 は研磨パッド 202 とスラリー S L による機械的除去作用によってさらに除去される。

【0083】このような構成とすることにより、上述した実施形態に係る研磨装置 1 と同様の効果が奏される。なお、研磨パッドに設ける陽極電極、陰極電極の配置は図 28 の構成に限定されるわけではなく、たとえば、図 30 に示すように、線状の複数の陽極電極 222 を縦横に等間隔に配列し、陽極電極 222 によって囲まれる各矩形領域に陰極電極 223 を配置し、陽極電極 222 と陰極電極 223 とを絶縁体 224 で電氣的に絶縁した研磨パッド 221 としてもよい。さらに、たとえば、図 31 に示すように、半径がそれぞれ異なる環状の陽極電極 242 を同心上に配置し、各陽極電極 242 間に形成される環状領域に陰極電極 243 をそれぞれ配置し、陽極電極 242 と陰極電極 243 とを絶縁体 244 で電氣的に絶縁した研磨パッド 241 としてもよい。

【0084】

【発明の効果】本発明によれば、機械研磨と電解研磨との複合作用によって金属膜を研磨するので、機械研磨による金属膜の平坦化の場合に比べて、非常に高能率に金属膜の凸部の選択的除去および平坦化が可能となる。また、本発明によれば、研磨工具を陰極として通電するため、予め正に帯電したパーティクルや研磨剤中の研磨砥粒が研磨工具に引き寄せられ、ウェーハ表面へ残留するのを防止することができ、歩留りの向上を図ることができる。また、本発明によれば、高能率に金属膜の除去が可能となるので、比較的低い研磨圧力でも十分な研磨レートが得られ、研磨した金属膜にスクラッチ、ディッシング、エロージョン等が発生するのを抑制することがで

きる。さらに、本発明によれば、比較的低い研磨圧力でも十分な研磨レートが得られたため、半導体装置の低消費電力化および高速化等の観点から誘電率を低減するために層間絶縁膜として機械的強度が比較的低い有機系低誘電率膜や多孔質低誘電率絶縁膜を使用した場合にも、容易に適用可能である。また、本発明によれば、層間絶縁膜上に残るバリヤ膜、あるいは、金属の部分は電解作用が働くことで効率的に除去され、絶縁膜の露出部分から溶出が停止するため、研磨の停止精度を自動的に確保することができ、ディッシング、エロージョンを抑制することができる。また、本発明によれば、電解電流をモニタリングすることで、研磨プロセスの管理を行うことができ、研磨プロセスの進行状態を正確に把握することが可能となる。また、本発明によれば、研磨工具と電極部材との間の電気抵抗値をモニタリングすることで、電流が流れにくい、または電流が流れない膜と金属膜とを同時に研磨するような場合でも、研磨プロセスを正確に管理することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の研磨装置の一実施形態の構成を示す図である。

【図 2】図 1 の研磨装置のヘッド部の詳細を示す拡大図である。

【図 3】(a) は電極板 23 の構造の一例を示す下面図であり、(b) は電極板 23 と、通電軸 20、スクラブ部材 24 および絶縁部材 4 との位置関係を示す断面図である。

【図 4】研磨工具とウェーハとの関係を示す図である。

【図 5】研磨工具に対してウェーハを X 軸方向に移動させた様子を示す図である。

【図 6】ヘッド加工部でウェーハを研磨加工する状態を示す概略図である。

【図 7】研磨工具と電極板との関係を示す図である。

【図 8】本発明の研磨装置の電解研磨機能を説明するための図である。

【図 9】本発明の半導体装置の製造方法の一実施形態に係る製造プロセスを示す工程図である。

【図 10】本発明の半導体装置の製造方法の製造プロセスを示す断面図である。

【図 11】図 10 に続く製造プロセスを示す断面図である。

【図 12】図 11 に続く製造プロセスを示す断面図である。

【図 13】図 12 に続く製造プロセスを示す断面図である。

【図 14】図 13 に続く製造プロセスを示す断面図である。

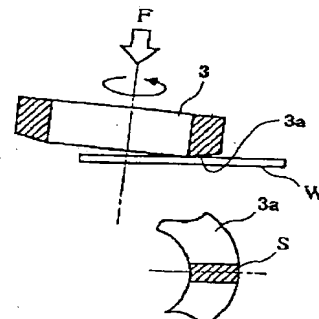
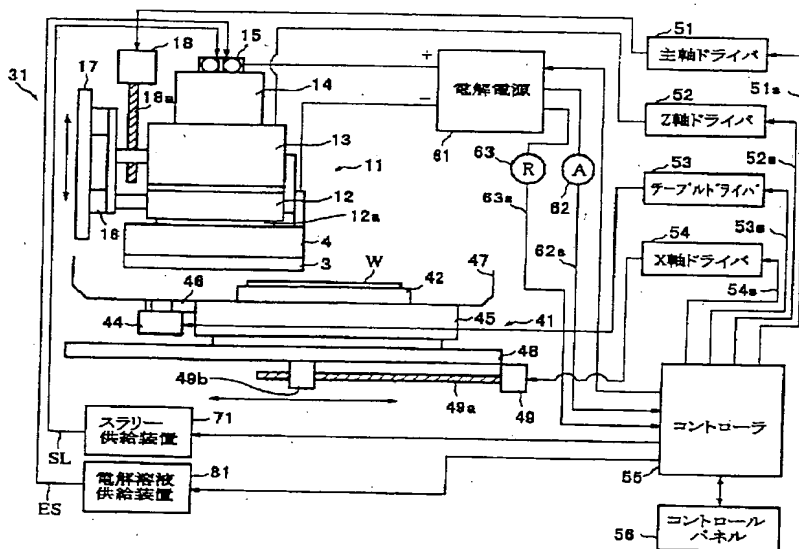
【図 15】図 14 に示す半導体装置の断面構造の拡大図である。

【図 16】図 14 に続く製造プロセスを示す断面図であ

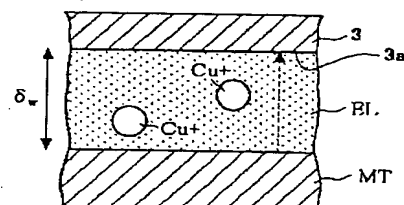
【図30】研磨パッドの電極構成の他の例を示す図であ\*

1…研磨装置、11…加工ヘッド部、61…電解電源、55…コントローラ55、71…スラリー供給装置、81…電解液供給装置。

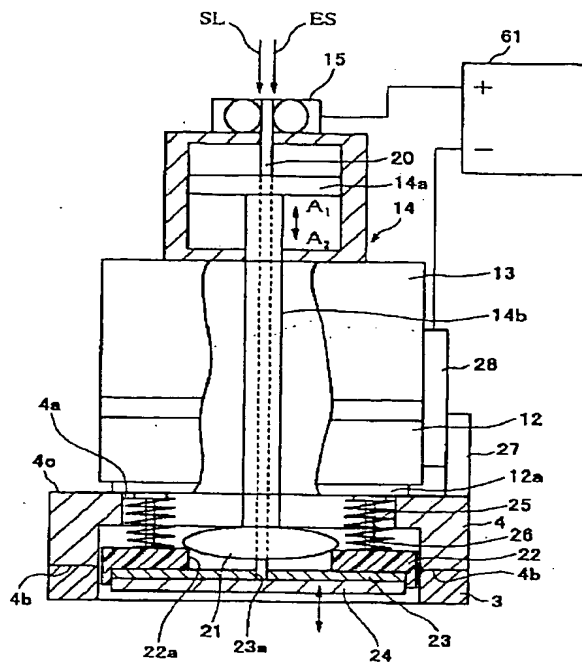
【図4】



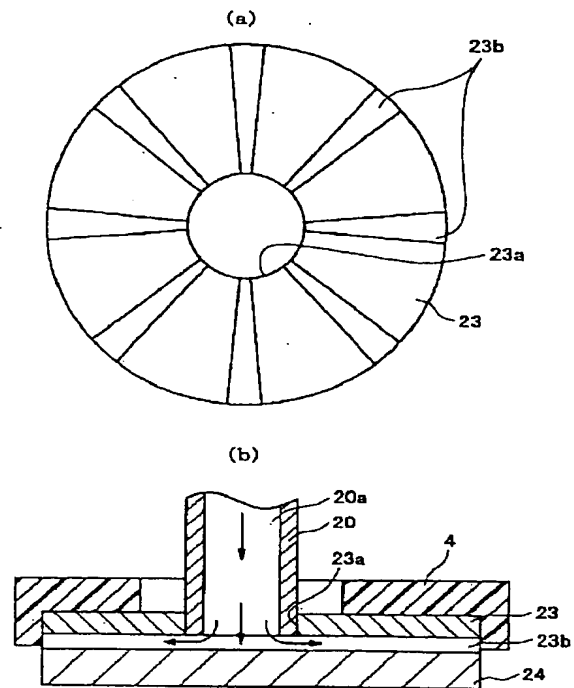
【图8】



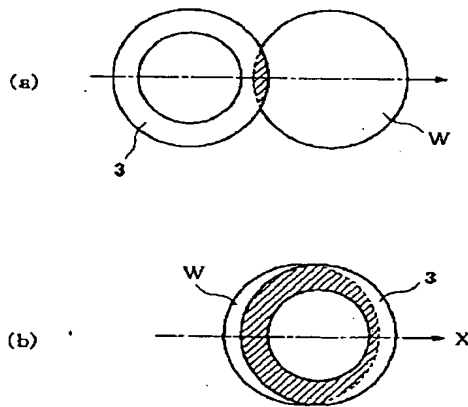
【図2】



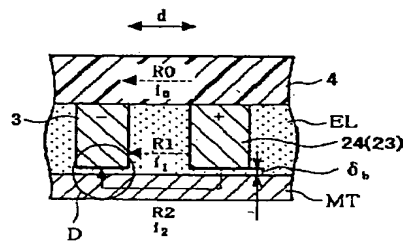
【図3】



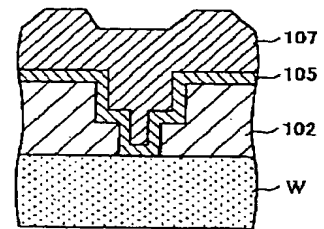
【図5】



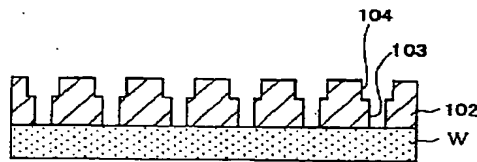
【図7】



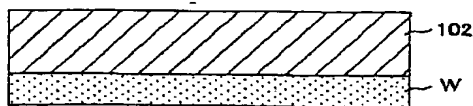
【図15】



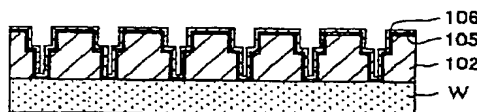
【図11】



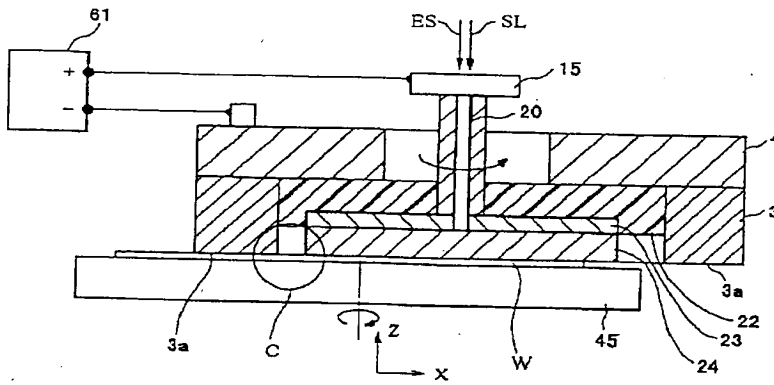
【図10】



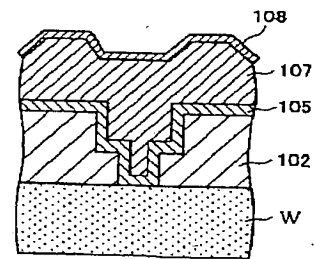
【図13】



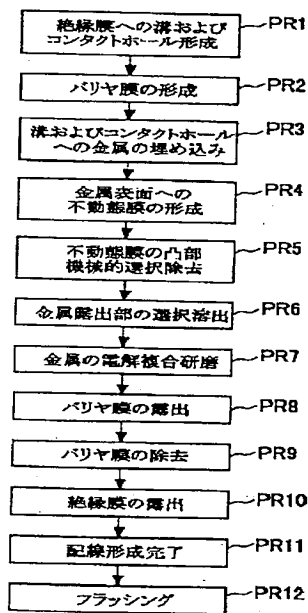
【図6】



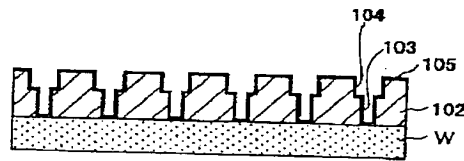
【図16】



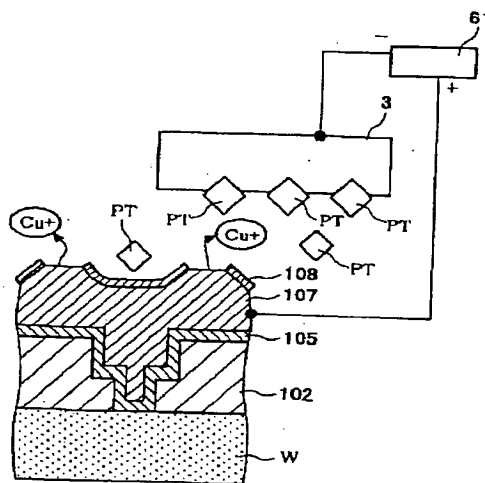
【図9】



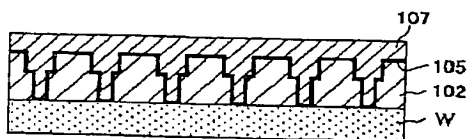
【図12】



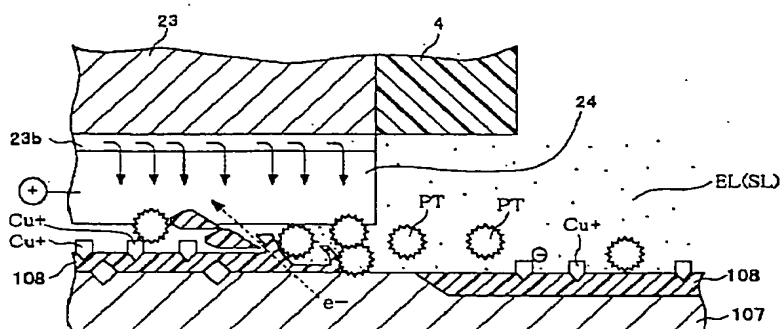
【図19】



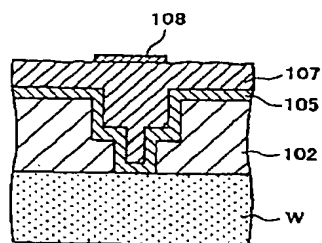
【図14】



【図17】

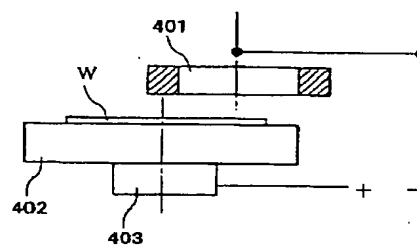
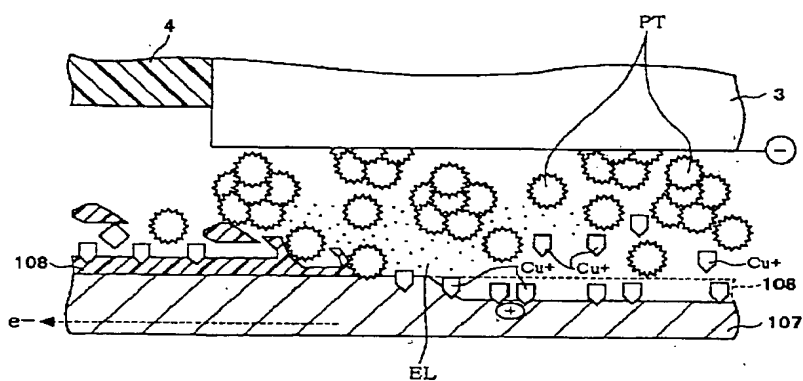


【図20】

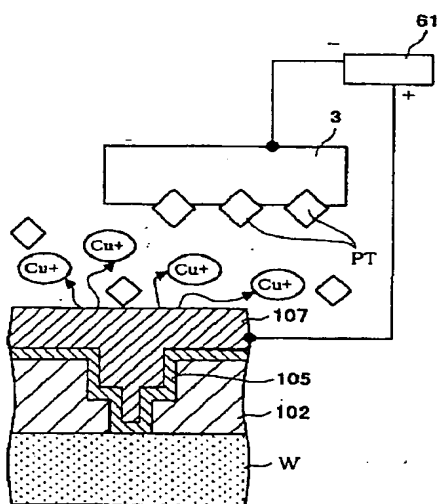


【図26】

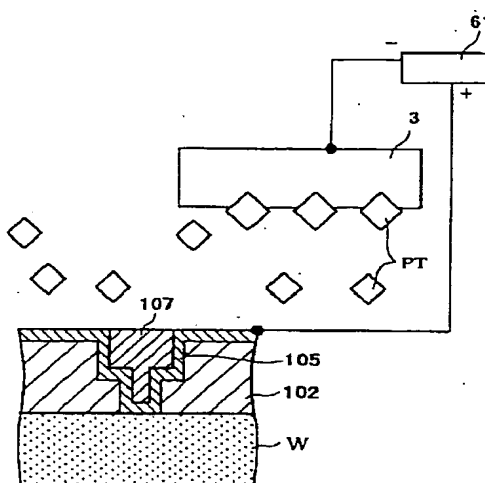
【図18】



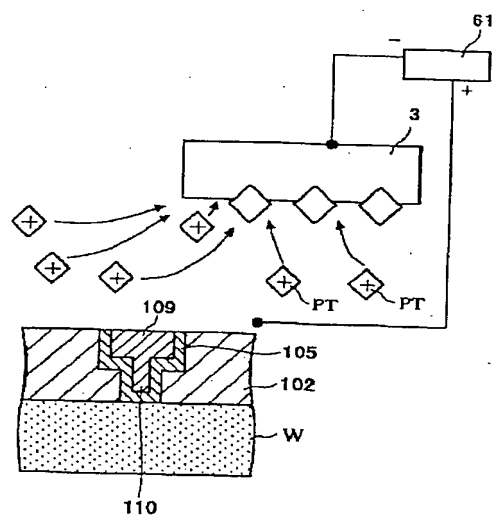
【図21】



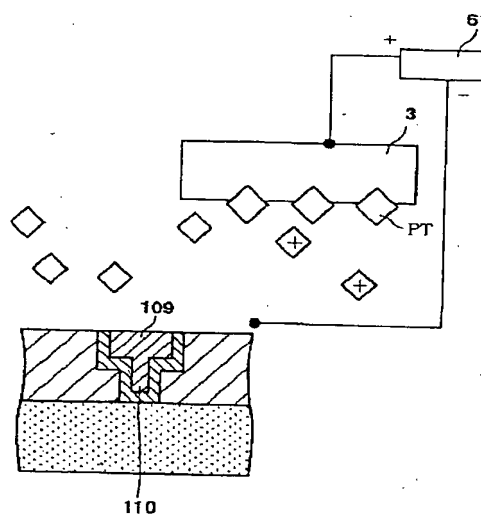
【図22】



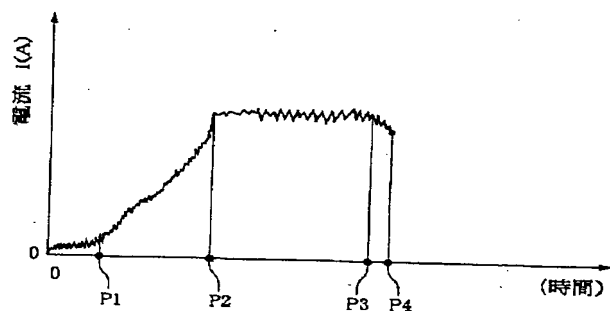
【図23】



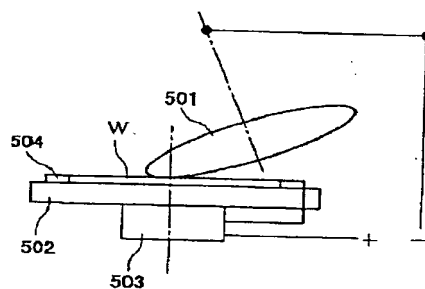
【図24】



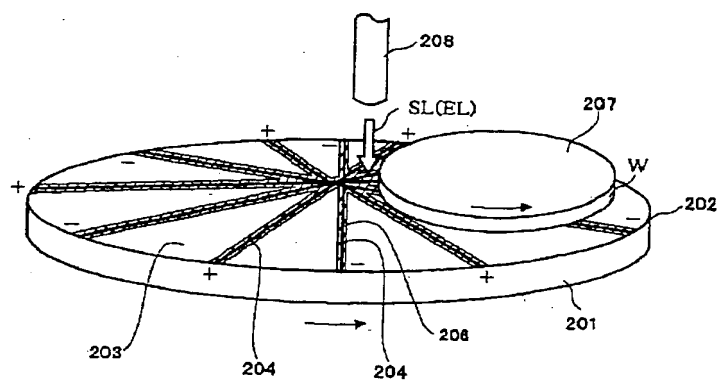
【図25】



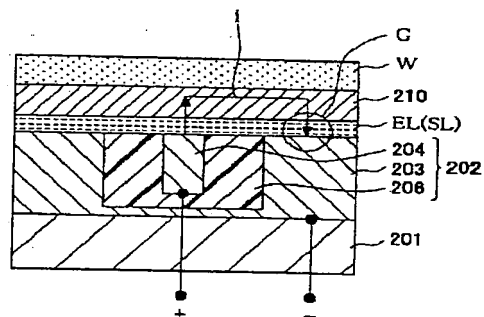
【図27】



【図28】

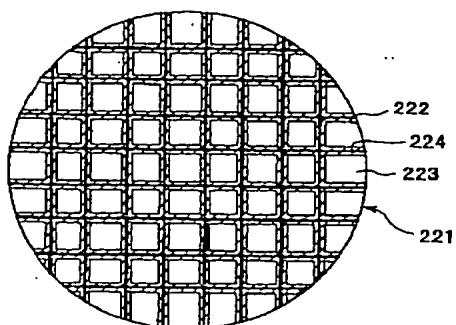


【図29】

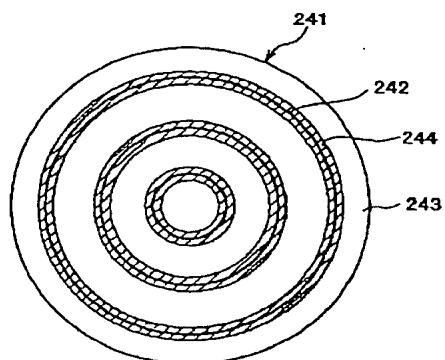




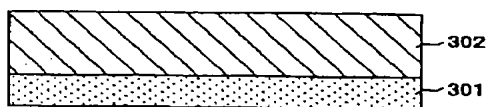
【図30】



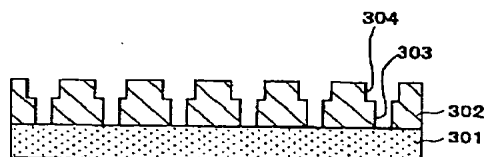
【図31】



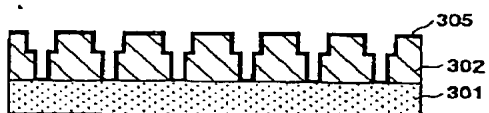
【図32】



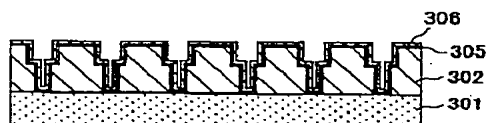
【図33】



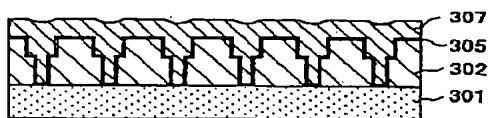
【図34】



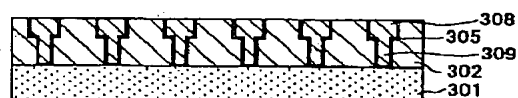
【図35】



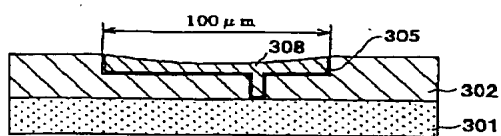
【図36】



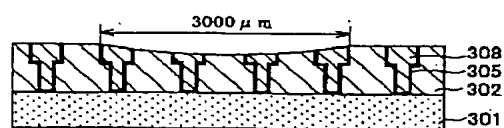
【図37】



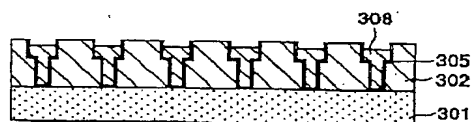
【図38】



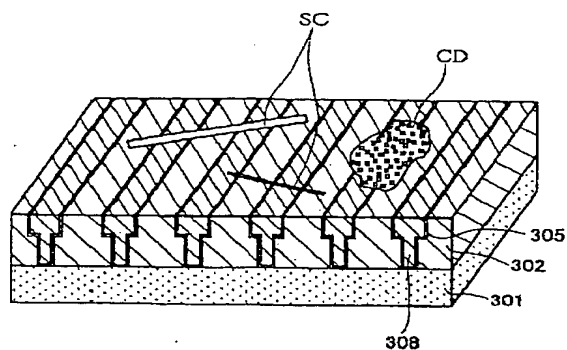
【図39】



【図40】



【図41】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

H01L 29/786

識別記号

F I

H01L 29/78

テーマコード (参考)

619A

(72)発明者 佐藤 修三

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内

Fターム(参考) 5F033 HH11 HH18 HH21 HH32 HH33

JJ11 JJ18 JJ21 JJ32 JJ33

KK01 MM02 PP06 PP14 PP15

PP19 PP27 PP28 PP33 QQ09

QQ37 QQ46 QQ48 QQ49 RR04

SS04 SS13 XX01

5F040 DC01 EJ03 EJ08 FC10

5F043 DD14 DD16 EE08 EE14 EE35

EE40 FF07 GG10

5F110 AA18 NN02 NN23 NN35 QQ19

QQ30